



2.4/5 GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi® 4 (802.11n) + Bluetooth® 5.2ソリューション

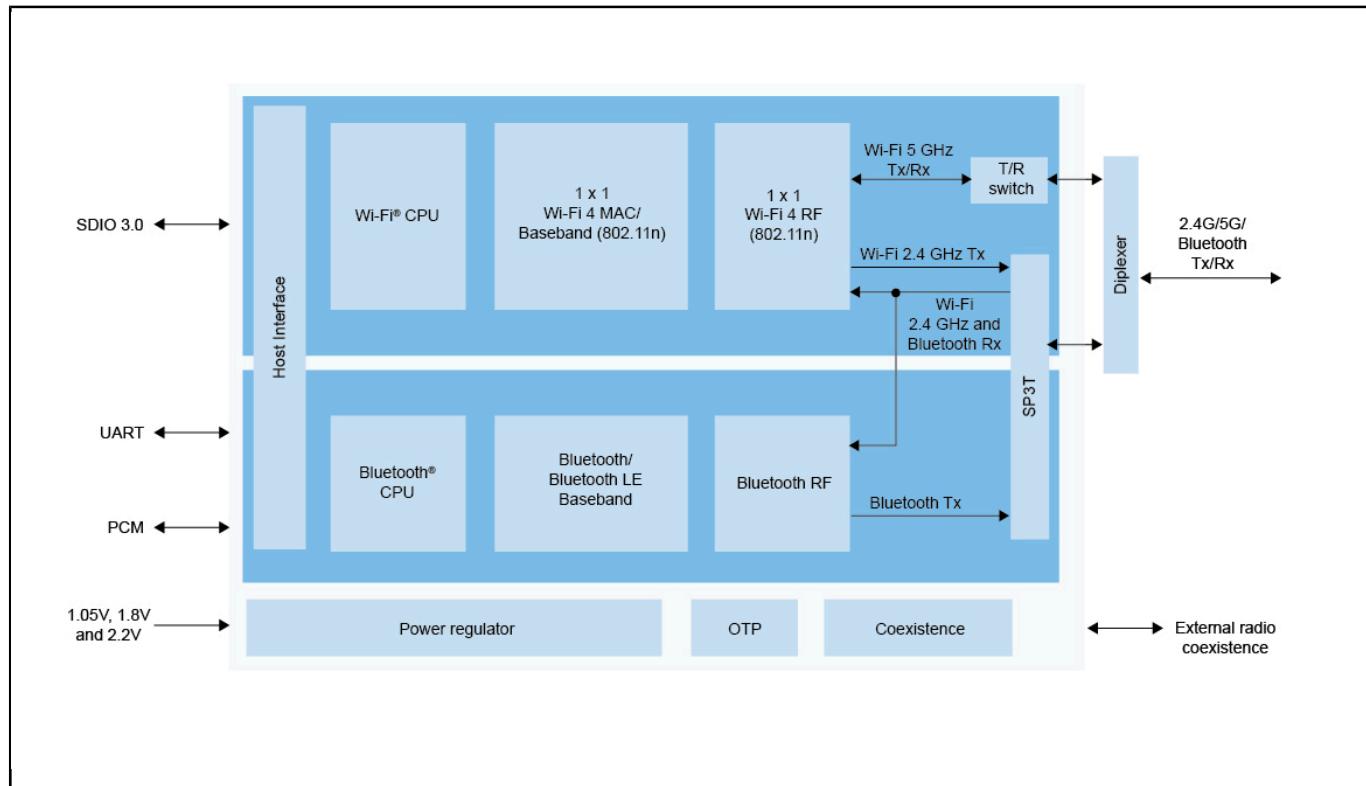
88W8977

Last Updated: May 25, 2023

88W8977システム・オン・チップ(SoC)は、Wi-Fi(2.4/5 GHz)とBluetoothテクノロジの両方を統合した高集積のシングルチップ・ソリューションです。このIEEE 802.11n準拠のデュアルバンド・システム・オン・チップは、最大MCS 7(150 Mbit/s)のWi-Fiデータ・レートを実現します。ウェアラブル、IoT(Internet of Things)、スマートホームなどのアプリケーションを対象としたデバイスの速度、信頼性、および品質要件をサポートするよう特別に設計されています。コンボ・ソリューションとして、IEEE 802.11n準拠の1x1空間ストリームと、高速かつIoT(Internet of Things)の機能を向上させるメッシュ・ネットワークを備えたBluetooth 5.2の同時運用および独立運用に対応します。

NXP 88W8977に基づく各種ワイヤレス・モジュールが、主要なモジュール・メーカーから提供されています。

88W8977のブロック図 Block Diagram



[View additional information for 2.4/5 GHzデュアルバンド1x1 Wi-Fi® 4 \(802.11n\) + Bluetooth® 5.2ソリューション.](#)

Note: The information on this document is subject to change without notice.

www.nxp.com

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.